

# Der ZVEI auf der electronica 2018

13. - 16. November 2018 | Messe München

Die ZVEI-Lounge befindet sich am Zugang zu Halle B1 über den Messeingang West.

Der ZVEI und seine Mitgliedsunternehmen gestalten das Vortragsprogramm im Forum des **PCB & Components Marketplace** in Halle A1. Daneben unterstützen wir die **electronica Automotive Conference** am 12. November im ICM und ebenso das **electronica Automotive Forum** in Halle B4 während der Messe. Die genauen Programminhalte dieser hochkarätig besetzten Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite der electronica und der electronica Termindatenbank. Weiterhin beteiligt sich der ZVEI am neuen Elektronik-Erlebnis und Karriere-Event, der **electronica Experience** in Halle C6.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

## Programm

### PCB & Components Marketplace, Speakers Corner, Halle A1.263

#### Dienstag 13.11.2018

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 12:00 - 12:30 Uhr | <b>Introduction to Condensation Reflow Soldering (Vapor Phase Soldering)</b><br>Marc van Stralen, IMDES Creative Solutions   |
| 12:30 - 13:00 Uhr | <b>Business Outlook: Global Electronics Industry (with emphasis on Europe)</b><br>Alun Morgan, für Custer Consulting Group   |
| 13:00 - 13:30 Uhr | <b>Inkjet technology for printing solder mask on PCBs</b><br>Erik Corduwener, Meyer Burger   |
| 13:30 - 14:00 Uhr | <b>Hybrid connectors for motion control devices</b><br>Rene Arntzen, Weidmüller Interface  |
| 14:00 - 17:00 Uhr | <b>How RFID in PCBs and Automation Makes the SMT-Line More Flexible, Reliable and a Highway to Industrie 4.0</b><br>Alexander Schmoltdt, Murata Electronics Europe et al |

**Mittwoch 14.11.2018**

- 09:30 - 10:00 Uhr**     **Parylenebeschichtung**  
Rudolf Heicks, Heicks Industrieelektronik
- 10:00 - 11:00 Uhr**     **Zukunft Autonomes Fahren - Elementare Designregeln als Schlüssel des Erfolgs**  
Arnold Wiemers, ILFA Feinstleitertechnik | Markus Biener, Zollner Elektronik | Michael Sturm, Weidmüller Interface
- 11:00 - 12:30 Uhr**     **Elektronische Komponenten und Systeme: Treiber für Innovation und Fortschritt – Roadmap Next Generation**  
Dr. Andreas Lock, Robert Bosch | Bernd Enser, Semikron International | Dr. Jan Marien, ISABELLENHÜTTE Heusler | Franz Bechtold, VIA electronic | Boris H. Buckow, EurA AG
- 12:30 - 14:15 Uhr**     **Erfolgslösungen mit Keramik - Basistechnik für elektronische Mikrosysteme**
- **Einführung und Motivation**  
Dirk Schönherr, Lust Hybrid Technik
  - **Dünnschichttechnik für Packaging, Schaltungen und Sensorik**  
Dr. Alexander Kaiser, Cicor Advanced Microelectronics & Substrates Div.
  - **Dickschicht-Hybrid Applikationen**  
André Kießig, Siegert electronic
  - **Schichtschaltungen auf Glas – Vorteile und Anwendungen**  
Johannes Schaefer, Turck Duotec
  - **Entwicklung eines autonomen Mikro-Flammenionisationsdetektors für den Explosionsschutz in zivilen Abwassernetzen**  
Franz Bechtold, Via electronic
  - **New Product Developments of LTCC-Ceramics**  
Dr. Sebastian Brunner, Qualcomm Austria RFFE

**Donnerstag 15.11.2018**

- 09:30 - 10:00 Uhr**    **When every heart beat counts**  
Holger Urban, Schaffner Deutschland
- 10:00 - 10:45 Uhr**    **The PCB Industry**  
**Part 1: Past - Present - Future | Part2: Production**  
Michael Gasch, DATA4PCB
- 11:00 - 12:30 Uhr**    Podiumsdiskussion  
**Management der Lieferfähigkeit – Material, Allokation, Obsoleszenz**
- Moderator:    Johann Wiesböck, Elektronikpraxis  
Teilnehmer    Michael Velmeden, cms electronics  
                   Helmut Bechtold, Profectus,  
                   Johann Weber, Zollner Elektronik  
                   Dietmar Günther, Sanmina-SCI  
                   Hans Ehm, Infineon Technologies
- 12:30 - 13:00 Uhr**    **Layouting as an online service**  
Dhanish Veena, Würth Elektronik
- 13:00 - 13:30 Uhr**    **Ultra fine-line hybrid solutions**  
Daniel Mitcan, Neways Deutschland
- 13:30 - 14:00 Uhr**    **Bauteilsauberkeit**  
Dr.-Ing. Helmut Schweigart, ZESTRON Europe

**Freitag 16.11.2018**

- 09:30 - 10:00 Uhr**    **Murata Integrated Passive Solution**  
Guillaume Raimbault, Murata Electronics Europe
- 10:00 - 10:30 Uhr**    **Recent Developments in Advanced HDI PCBs**  
Roger Massey, Atotech Deutschland
- 10:30 - 11:00 Uhr**    **Professional handling of obsolescence cases with pcn.cockpit**  
Dr. Wolfgang Heinbach, D+D+M Daten- und Dokumentations-Management
- 11:00 - 12:30 Uhr**    **Be clever - use lever**  
Matthias Giese, WAGO Kontakttechnik

**electronica Experience, Halle C6**

- täglich von            **Auf der "Discovery Stage" beteiligt sich der ZVEI am Vortragsprogramm für**  
**09:00 - 18:00 Uhr**    **rund 1.600 Schüler und am Stand 307 informieren wir im Rahmen der "Coole**  
**Technik trifft junge Leute" Kampagne über Ausbildung, Berufsbilder und**  
**Studiengänge der Elektroindustrie**